



2026-2032全球与中国混合键合材料市场调研报告

【行业】:化工及材料 【报告编码】:179186089399225

【出版时间】:2026-10-13 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

内容摘要

根据统计及预测，2025年全球混合键合材料市场销售额达到了0.65亿美元，预计2032年将达到2.50亿美元，年复合增长率（CAGR）为21.2%（2026-2032）。

混合键合材料是用于半导体晶圆对晶圆、芯粒对晶圆或芯粒对芯粒混合键合工艺的一组高纯度功能材料，核心包括介质键合层、铜互连及电镀化学品、CMP抛光液与抛光垫、后CMP清洗和表面活化化学品，以及薄晶圆搬运所需的临时支撑材料。其作用是在同一界面同时形成介质-介质机械连接和金属-金属电连接，要求具备纳米级平坦度控制、极低颗粒与金属污染、低铜凹陷、良好界面润湿和低温键合兼容性，主要用于HBM、先进逻辑、图像传感器和芯粒3D集成。综合毛利率约52%。

下游需求主要由AI加速器、高带宽存储器、先进逻辑芯片和芯粒架构推动。随着互连间距继续缩小，传统微凸点在带宽、功耗和互连密度方面逐步接近瓶颈，混合键合开始从图像传感器和部分逻辑堆叠扩展到HBM、缓存堆叠和异构集成，带动专用介质、铜互连、抛光与清洗材料用量增长。

产品升级集中在铜与介质共平面控制、低铜凹陷CMP、低缺陷后清洗、SiCN和聚合物介质体系、低温表面活化及临时承载材料。材料配方通常需要针对客户结构、铜密度和设备条件联合开发，认证周期长，供应格局以全球电子化学品企业、CMP材料厂商和少数键合材料专业公司为主，具备多材料协同优化和本地技术服务能力的供应商更容易进入量产线。

亚洲是主要采购和量产区域，需求集中在中国台湾、韩国、日本和中国大陆的晶圆厂、存储厂及先进封装企业，北美和欧洲则在先进逻辑、研究开发和设备材料协同方面保持较强影响力。主要风险来自HBM导入节奏变化、颗粒和界面缺陷导致的良率压力、客户定制配方难以跨平台复制，以及出口管制和供应链本地化要求；机会集中在低温键合、芯粒级键合、国产替代和一体化材料方案。

报告范围

本报告研究全球与中国市场混合键合材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年，预测数据为2026至2032年。

主要厂商包括：

富士胶片
默克
英特格
杜邦
Brewer Science
日产化学
JSR
东京应化
AGC
Qnity
力森诺科
安集微电子
上海新阳
鼎龙股份
圣戈班

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

- 介质键合材料
- 金属互连材料
- CMP抛光液与抛光垫
- 清洗与活化化学品
- 临时支撑材料
- 其他工艺材料

按照不同键合界面，包括如下几个类别：

- 铜/氧化硅界面
- 铜/碳氮化硅界面
- 铜/聚合物界面
- 其他金属/介质界面

按照不同工艺阶段，包括如下几个类别：

- 介质层形成
- 金属化
- 平坦化
- 清洗与表面活化
- 键合与退火
- 临时承载与解键合

按照不同键合温度，包括如下几个类别：

- 超低温级（ $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ）
- 低温级（ $> 100\text{-}200^{\circ}\text{C}$ ）
- 中温级（ $> 200\text{-}300^{\circ}\text{C}$ ）
- 高温级（ $> 300^{\circ}\text{C}$ ）
- 其他温度等级

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

- 高带宽存储与存储芯片堆叠
- 逻辑芯片与Chiplet封装
- CMOS图像传感器
- 硅光与光电器件
- MEMS与传感器器件
- 其他三维异质集成

重点关注如下几个地区

- 北美
- 欧洲
- 中国
- 日本
- 印度
- 东南亚

章节概要

- 第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
- 第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
- 第3章：全球混合键合材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
- 第4章：全球范围内混合键合材料主要厂商竞争分析，主要包括混合键合材料产能、销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析
- 第5章：全球混合键合材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、混合键合材料产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
- 第6章：全球不同产品类型混合键合材料销量、收入、价格及份额等
- 第7章：全球不同应用混合键合材料销量、收入、价格及份额等
- 第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
- 第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
- 第10章：报告结论

报告目录

1 混合键合材料市场概述

1.1 产品定义及统计范围

1.2 按照不同产品类型，混合键合材料主要可以分为如下几个类别

1.2.1 全球不同产品类型混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.2.2 介质键合材料

1.2.3 金属互连材料

1.2.4 CMP抛光液与抛光垫

1.2.5 清洗与活化化学品

1.2.6 临时支撑材料

1.2.7 其他工艺材料

1.3 按照不同键合界面，混合键合材料主要可以分为如下几个类别

1.3.1 全球不同键合界面混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.3.2 铜/氧化硅界面

1.3.3 铜/碳氮化硅界面

1.3.4 铜/聚合物界面

1.3.5 其他金属/介质界面

1.4 按照不同工艺阶段，混合键合材料主要可以分为如下几个类别

1.4.1 全球不同工艺阶段混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.4.2 介质层形成

1.4.3 金属化

1.4.4 平坦化

1.4.5 清洗与表面活化

1.4.6 键合与退火

1.4.7 临时承载与解键合

1.5 按照不同键合温度，混合键合材料主要可以分为如下几个类别

1.5.1 全球不同键合温度混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.5.2 超低温级 ($\leq 100^{\circ}\text{C}$)

1.5.3 低温级 ($>100-200^{\circ}\text{C}$)

1.5.4 中温级 ($>200-300^{\circ}\text{C}$)

1.5.5 高温级 ($>300^{\circ}\text{C}$)

1.5.6 其他温度等级

1.6 从不同应用，混合键合材料主要包括如下几个方面

1.6.1 全球不同应用混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032

1.6.2 高带宽存储与存储芯片堆叠

1.6.3 逻辑芯片与Chiplet封装

1.6.4 CMOS图像传感器

1.6.5 硅光与光电器件

1.6.6 MEMS与传感器器件

1.6.7 其他三维异质集成

1.7 混合键合材料行业背景、发展历史、现状及趋势

1.7.1 混合键合材料行业目前现状分析

1.7.2 混合键合材料发展趋势

2 全球混合键合材料总体规模分析

2.1 全球混合键合材料供需现状及预测 (2021-2032)

2.1.1 全球混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032)

2.1.2 全球混合键合材料产量、需求量及发展趋势 (2021-2032)

2.2 全球主要地区混合键合材料产量及发展趋势 (2021-2032)

2.2.1 全球主要地区混合键合材料产量 (2021-2026)

2.2.2 全球主要地区混合键合材料产量 (2027-2032)

2.2.3 全球主要地区混合键合材料产量市场份额 (2021-2032)

2.3 中国混合键合材料供需现状及预测 (2021-2032)

2.3.1 中国混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032)

2.3.2 中国混合键合材料产量、市场需求量及发展趋势 (2021-2032)

2.4 全球混合键合材料销量及销售额

2.4.1 全球市场混合键合材料销售额 (2021-2032)

2.4.2 全球市场混合键合材料销量 (2021-2032)

2.4.3 全球市场混合键合材料价格趋势 (2021-2032)

3 全球混合键合材料主要地区分析

3.1 全球主要地区混合键合材料市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032

3.1.1 全球主要地区混合键合材料销售收入及市场份额 (2021-2026)

- 3.1.2 全球主要地区混合键合材料销售收入预测（2027-2032）
- 3.2 全球主要地区混合键合材料销量分析：2021 VS 2025 VS 2032
 - 3.2.1 全球主要地区混合键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 - 3.2.2 全球主要地区混合键合材料销量及市场份额预测（2027-2032）
- 3.3 北美市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.4 欧洲市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.5 中国市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.6 日本市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.7 东南亚市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 3.8 印度市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
- 4 全球与中国主要厂商市场份额分析
 - 4.1 全球市场主要厂商混合键合材料产能市场份额
 - 4.2 全球市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 - 4.2.1 全球市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 - 4.2.2 全球市场主要厂商混合键合材料销售收入（2021-2026）
 - 4.2.3 全球市场主要厂商混合键合材料销售价格（2021-2026）
 - 4.2.4 2025年全球主要生产商混合键合材料收入排名
 - 4.3 中国市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 - 4.3.1 中国市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 - 4.3.2 中国市场主要厂商混合键合材料销售收入（2021-2026）
 - 4.3.3 2025年中国主要生产商混合键合材料收入排名
 - 4.3.4 中国市场主要厂商混合键合材料销售价格（2021-2026）
 - 4.4 全球主要厂商混合键合材料总部及产地分布
 - 4.5 全球主要厂商成立时间及混合键合材料商业化日期
 - 4.6 全球主要厂商混合键合材料产品类型及应用
 - 4.7 混合键合材料行业集中度、竞争程度分析
 - 4.7.1 混合键合材料行业集中度分析：2025年全球Top 5生产商市场份额
 - 4.7.2 全球混合键合材料第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
 - 4.8 新增投资及市场并购活动
- 5 全球主要生产商分析
 - 5.1 富士胶片
 - 5.1.1 富士胶片基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.1.2 富士胶片 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.1.3 富士胶片 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.1.4 富士胶片公司简介及主要业务
 - 5.1.5 富士胶片企业最新动态
 - 5.2 默克
 - 5.2.1 默克基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.2.2 默克 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.2.3 默克 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.2.4 默克公司简介及主要业务
 - 5.2.5 默克企业最新动态
 - 5.3 英特格
 - 5.3.1 英特格基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.3.2 英特格 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.3.3 英特格 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.3.4 英特格公司简介及主要业务
 - 5.3.5 英特格企业最新动态
 - 5.4 杜邦
 - 5.4.1 杜邦基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.4.2 杜邦 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.4.3 杜邦 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.4.4 杜邦公司简介及主要业务
 - 5.4.5 杜邦企业最新动态
 - 5.5 Brewer Science
 - 5.5.1 Brewer Science基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 - 5.5.2 Brewer Science 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 - 5.5.3 Brewer Science 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 - 5.5.4 Brewer Science公司简介及主要业务
 - 5.5.5 Brewer Science企业最新动态

5.6 日产化学

5.6.1 日产化学基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.6.2 日产化学 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.6.3 日产化学 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.6.4 日产化学公司简介及主要业务

5.6.5 日产化学企业最新动态

5.7 JSR

5.7.1 JSR基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.7.2 JSR 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.7.3 JSR 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.7.4 JSR公司简介及主要业务

5.7.5 JSR企业最新动态

5.8 东京应化

5.8.1 东京应化基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.8.2 东京应化 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.8.3 东京应化 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.8.4 东京应化公司简介及主要业务

5.8.5 东京应化企业最新动态

5.9 AGC

5.9.1 AGC基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.9.2 AGC 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.9.3 AGC 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.9.4 AGC公司简介及主要业务

5.9.5 AGC企业最新动态

5.10 Qnity

5.10.1 Qnity基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.10.2 Qnity 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.10.3 Qnity 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.10.4 Qnity公司简介及主要业务

5.10.5 Qnity企业最新动态

5.11 力森诺科

5.11.1 力森诺科基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.11.2 力森诺科 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.11.3 力森诺科 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.11.4 力森诺科公司简介及主要业务

5.11.5 力森诺科企业最新动态

5.12 安集微电子

5.12.1 安集微电子基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.12.2 安集微电子 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.12.3 安集微电子 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.12.4 安集微电子公司简介及主要业务

5.12.5 安集微电子企业最新动态

5.13 上海新阳

5.13.1 上海新阳基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.13.2 上海新阳 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.13.3 上海新阳 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.13.4 上海新阳公司简介及主要业务

5.13.5 上海新阳企业最新动态

5.14 鼎龙股份

5.14.1 鼎龙股份基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.14.2 鼎龙股份 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.14.3 鼎龙股份 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.14.4 鼎龙股份公司简介及主要业务

5.14.5 鼎龙股份企业最新动态

5.15 圣戈班

5.15.1 圣戈班基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

5.15.2 圣戈班 混合键合材料产品规格、参数及市场应用

5.15.3 圣戈班 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.15.4 圣戈班公司简介及主要业务

5.15.5 圣戈班企业最新动态

- 6 不同产品类型混合键合材料分析
 - 6.1 全球不同产品类型混合键合材料销量（2021-2032）
 - 6.1.1 全球不同产品类型混合键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 - 6.1.2 全球不同产品类型混合键合材料销量预测（2027-2032）
 - 6.2 全球不同产品类型混合键合材料收入（2021-2032）
 - 6.2.1 全球不同产品类型混合键合材料收入及市场份额（2021-2026）
 - 6.2.2 全球不同产品类型混合键合材料收入预测（2027-2032）
 - 6.3 全球不同产品类型混合键合材料价格走势（2021-2032）
- 7 不同应用混合键合材料分析
 - 7.1 全球不同应用混合键合材料销量（2021-2032）
 - 7.1.1 全球不同应用混合键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 - 7.1.2 全球不同应用混合键合材料销量预测（2027-2032）
 - 7.2 全球不同应用混合键合材料收入（2021-2032）
 - 7.2.1 全球不同应用混合键合材料收入及市场份额（2021-2026）
 - 7.2.2 全球不同应用混合键合材料收入预测（2027-2032）
 - 7.3 全球不同应用混合键合材料价格走势（2021-2032）
- 8 上游原料及下游市场分析
 - 8.1 混合键合材料产业链分析
 - 8.2 混合键合材料工艺制造技术分析
 - 8.3 混合键合材料产业上游供应分析
 - 8.3.1 上游原料供给状况
 - 8.3.2 原料供应商及联系方式
 - 8.4 混合键合材料下游客户分析
 - 8.5 混合键合材料销售渠道分析
- 9 行业发展机遇和风险分析
 - 9.1 混合键合材料行业发展机遇及主要驱动因素
 - 9.2 混合键合材料行业发展面临的风险
 - 9.3 混合键合材料行业政策分析
 - 9.4 美国对华关税对行业的影响分析
 - 9.5 中国企业SWOT分析
- 10 研究成果及结论
- 11 附录
 - 11.1 研究方法
 - 11.2 数据来源
 - 11.2.1 二手信息来源
 - 11.2.2 一手信息来源
 - 11.3 数据交互验证
 - 11.4 免责声明

报告图表

表格目录

- 表 1： 全球不同产品类型混合键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 2： 全球不同键合界面混合键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 3： 全球不同工艺阶段混合键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 4： 全球不同键合温度混合键合材料销售额增长（CAGR）趋势2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 5： 全球不同应用销售额增速（CAGR） 2021 VS 2025 VS 2032（百万美元）
- 表 6： 混合键合材料行业目前发展现状
- 表 7： 混合键合材料发展趋势
- 表 8： 全球主要地区混合键合材料产量增速（CAGR）：（2021 VS 2025 VS 2032）&（千克）
- 表 9： 全球主要地区混合键合材料产量（2021-2026）&（千克）
- 表 10： 全球主要地区混合键合材料产量（2027-2032）&（千克）
- 表 11： 全球主要地区混合键合材料产量市场份额（2021-2026）
- 表 12： 全球主要地区混合键合材料产量市场份额（2027-2032）
- 表 13： 全球主要地区混合键合材料销售收入增速：（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）

表 14:	全球主要地区混合键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 15:	全球主要地区混合键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 16:	全球主要地区混合键合材料收入 (2027-2032) & (百万美元)
表 17:	全球主要地区混合键合材料收入市场份额 (2027-2032)
表 18:	全球主要地区混合键合材料销量 (千克) : 2021 VS 2025 VS 2032
表 19:	全球主要地区混合键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 20:	全球主要地区混合键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 21:	全球主要地区混合键合材料销量 (2027-2032) & (千克)
表 22:	全球主要地区混合键合材料销量份额 (2027-2032)
表 23:	全球市场主要厂商混合键合材料产能 (2025-2026) & (千克)
表 24:	全球市场主要厂商混合键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 25:	全球市场主要厂商混合键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 26:	全球市场主要厂商混合键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 27:	全球市场主要厂商混合键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 28:	全球市场主要厂商混合键合材料销售价格 (2021-2026) & (美元/千克)
表 29:	2025年全球主要生产商混合键合材料收入排名 (百万美元)
表 30:	中国市场主要厂商混合键合材料销量 (2021-2026) & (千克)
表 31:	中国市场主要厂商混合键合材料销量市场份额 (2021-2026)
表 32:	中国市场主要厂商混合键合材料销售收入 (2021-2026) & (百万美元)
表 33:	中国市场主要厂商混合键合材料销售收入市场份额 (2021-2026)
表 34:	2025年中国主要生产商混合键合材料收入排名 (百万美元)
表 35:	中国市场主要厂商混合键合材料销售价格 (2021-2026) & (美元/千克)
表 36:	全球主要厂商混合键合材料总部及产地分布
表 37:	全球主要厂商成立时间及混合键合材料商业化日期
表 38:	全球主要厂商混合键合材料产品类型及应用
表 39:	2025年全球混合键合材料主要厂商市场地位 (第一梯队、第二梯队和第三梯队)
表 40:	全球混合键合材料市场投资、并购等现状分析
表 41:	富士胶片 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 42:	富士胶片 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 43:	富士胶片 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 44:	富士胶片公司简介及主要业务
表 45:	富士胶片企业最新动态
表 46:	默克 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 47:	默克 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 48:	默克 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 49:	默克公司简介及主要业务
表 50:	默克企业最新动态
表 51:	英特格 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 52:	英特格 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 53:	英特格 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 54:	英特格公司简介及主要业务
表 55:	英特格企业最新动态
表 56:	杜邦 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 57:	杜邦 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 58:	杜邦 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 59:	杜邦公司简介及主要业务
表 60:	杜邦企业最新动态
表 61:	Brewer Science 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 62:	Brewer Science 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 63:	Brewer Science 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 64:	Brewer Science公司简介及主要业务
表 65:	Brewer Science企业最新动态
表 66:	日产化学 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 67:	日产化学 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 68:	日产化学 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)
表 69:	日产化学公司简介及主要业务
表 70:	日产化学企业最新动态
表 71:	JSR 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 72:	JSR 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 73:	JSR 混合键合材料销量 (千克)、收入 (百万美元)、价格 (美元/千克) 及毛利率 (2021-2026)

表 74:	JSR公司简介及主要业务
表 75:	JSR企业最新动态
表 76:	东京应化 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 77:	东京应化 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 78:	东京应化 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 79:	东京应化公司简介及主要业务
表 80:	东京应化企业最新动态
表 81:	AGC 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 82:	AGC 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 83:	AGC 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 84:	AGC公司简介及主要业务
表 85:	AGC企业最新动态
表 86:	Qnity 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 87:	Qnity 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 88:	Qnity 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 89:	Qnity公司简介及主要业务
表 90:	Qnity企业最新动态
表 91:	力森诺科 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 92:	力森诺科 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 93:	力森诺科 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 94:	力森诺科公司简介及主要业务
表 95:	力森诺科企业最新动态
表 96:	安集微电子 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 97:	安集微电子 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 98:	安集微电子 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 99:	安集微电子公司简介及主要业务
表 100:	安集微电子企业最新动态
表 101:	上海新阳 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 102:	上海新阳 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 103:	上海新阳 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 104:	上海新阳公司简介及主要业务
表 105:	上海新阳企业最新动态
表 106:	鼎龙股份 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 107:	鼎龙股份 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 108:	鼎龙股份 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 109:	鼎龙股份公司简介及主要业务
表 110:	鼎龙股份企业最新动态
表 111:	圣戈班 混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
表 112:	圣戈班 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
表 113:	圣戈班 混合键合材料销量（千克）、收入（百万美元）、价格（美元/千克）及毛利率（2021-2026）
表 114:	圣戈班公司简介及主要业务
表 115:	圣戈班企业最新动态
表 116:	全球不同产品类型混合键合材料销量（2021-2026）&（千克）
表 117:	全球不同产品类型混合键合材料销量市场份额（2021-2026）
表 118:	全球不同产品类型混合键合材料销量预测（2027-2032）&（千克）
表 119:	全球市场不同产品类型混合键合材料销量市场份额预测（2027-2032）
表 120:	全球不同产品类型混合键合材料收入（2021-2026）&（百万美元）
表 121:	全球不同产品类型混合键合材料收入市场份额（2021-2026）
表 122:	全球不同产品类型混合键合材料收入预测（2027-2032）&（百万美元）
表 123:	全球不同产品类型混合键合材料收入市场份额预测（2027-2032）
表 124:	全球不同应用混合键合材料销量（2021-2026）&（千克）
表 125:	全球不同应用混合键合材料销量市场份额（2021-2026）
表 126:	全球不同应用混合键合材料销量预测（2027-2032）&（千克）
表 127:	全球市场不同应用混合键合材料销量市场份额预测（2027-2032）
表 128:	全球不同应用混合键合材料收入（2021-2026）&（百万美元）
表 129:	全球不同应用混合键合材料收入市场份额（2021-2026）
表 130:	全球不同应用混合键合材料收入预测（2027-2032）&（百万美元）
表 131:	全球不同应用混合键合材料收入市场份额预测（2027-2032）
表 132:	混合键合材料上游原料供应商及联系方式列表
表 133:	混合键合材料典型客户列表

表 134: 混合键合材料主要销售模式及销售渠道
表 135: 混合键合材料行业发展机遇及主要驱动因素
表 136: 混合键合材料行业发展面临的风险
表 137: 混合键合材料行业政策分析
表 138: 研究范围
表 139: 本文分析师列表

图表目录

图 1: 混合键合材料产品图片
图 2: 全球不同产品类型混合键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 3: 全球不同产品类型混合键合材料市场份额2025 & 2032
图 4: 介质键合材料产品图片
图 5: 金属互连材料产品图片
图 6: CMP抛光液与抛光垫产品图片
图 7: 清洗与活化化学品产品图片
图 8: 临时支撑材料产品图片
图 9: 其他工艺材料产品图片
图 10: 全球不同键合界面混合键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 11: 全球不同键合界面混合键合材料市场份额2025 & 2032
图 12: 铜/氧化硅界面产品图片
图 13: 铜/碳氮化硅界面产品图片
图 14: 铜/聚合物界面产品图片
图 15: 其他金属/介质界面产品图片
图 16: 全球不同工艺阶段混合键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 17: 全球不同工艺阶段混合键合材料市场份额2025 & 2032
图 18: 介质层形成产品图片
图 19: 金属化产品图片
图 20: 平坦化产品图片
图 21: 清洗与表面活化产品图片
图 22: 键合与退火产品图片
图 23: 临时承载与解键合产品图片
图 24: 全球不同键合温度混合键合材料销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 25: 全球不同键合温度混合键合材料市场份额2025 & 2032
图 26: 超低温级 ($\leq 100^{\circ}\text{C}$) 产品图片
图 27: 低温级 ($>100\text{-}200^{\circ}\text{C}$) 产品图片
图 28: 中温级 ($>200\text{-}300^{\circ}\text{C}$) 产品图片
图 29: 高温级 ($>300^{\circ}\text{C}$) 产品图片
图 30: 其他温度等级产品图片
图 31: 全球不同应用销售额2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 32: 全球不同应用混合键合材料市场份额2025 & 2032
图 33: 高带宽存储与存储芯片堆叠
图 34: 逻辑芯片与Chiplet封装
图 35: CMOS图像传感器
图 36: 硅光与光电器件
图 37: MEMS与传感器器件
图 38: 其他三维异质集成
图 39: 全球混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 40: 全球混合键合材料产量、需求量及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 41: 全球主要地区混合键合材料产量 (2021 VS 2025 VS 2032) & (千克)
图 42: 全球主要地区混合键合材料产量市场份额 (2021-2032)
图 43: 中国混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 44: 中国混合键合材料产量、市场需求量及发展趋势 (2021-2032) & (千克)
图 45: 全球混合键合材料市场销售额及增长率: (2021-2032) & (百万美元)
图 46: 全球市场混合键合材料市场规模: 2021 VS 2025 VS 2032 (百万美元)
图 47: 全球市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
图 48: 全球市场混合键合材料价格趋势 (2021-2032) & (美元/千克)
图 49: 全球主要地区混合键合材料销售收入 (2021 VS 2025 VS 2032) & (百万美元)
图 50: 全球主要地区混合键合材料销售收入市场份额 (2021 VS 2025)
图 51: 北美市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)

- 图 52: 北美市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 53: 欧洲市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
- 图 54: 欧洲市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 55: 中国市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
- 图 56: 中国市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 57: 日本市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
- 图 58: 日本市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 59: 东南亚市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
- 图 60: 东南亚市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 61: 印度市场混合键合材料销量及增长率 (2021-2032) & (千克)
- 图 62: 印度市场混合键合材料收入及增长率 (2021-2032) & (百万美元)
- 图 63: 2025年全球市场主要厂商混合键合材料销量市场份额
- 图 64: 2025年全球市场主要厂商混合键合材料收入市场份额
- 图 65: 2025年中国市场主要厂商混合键合材料销量市场份额
- 图 66: 2025年中国市场主要厂商混合键合材料收入市场份额
- 图 67: 2025年全球前五大生产商混合键合材料市场份额
- 图 68: 2025年全球混合键合材料第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
- 图 69: 全球不同产品类型混合键合材料价格走势 (2021-2032) & (美元/千克)
- 图 70: 全球不同应用混合键合材料价格走势 (2021-2032) & (美元/千克)
- 图 71: 混合键合材料产业链
- 图 72: 混合键合材料中国企业SWOT分析
- 图 73: 关键采访目标
- 图 74: 自下而上及自上而下验证
- 图 75: 资料三角测定